

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2018-011

**广东惠伦晶体科技股份有限公司**  
**关于公司表面贴装温度补偿振荡器（TCX0）产品**  
**通过 MTK 认证公告的补充公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年3月22日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露了《关于公司表面贴装温度补偿振荡器（TCX0）产品通过MTK认证的公告》（公告编号：2018-010号）。因公告内容相对简单，不便于投资者理解，特补充公告如下。

温度补偿晶体振荡器又称温补晶振，英文简称为TCX0(Temperature Compensated Crystal Oscillator)，指定工作温度范围内通过芯片对晶振（Crystal）3次或5次温度特性曲线进行反补偿(电压补偿)保持晶振频率不受外部温度影响，保持高精度输出(如 $10^{-7}$ 级、 $10^{-6}$  级)的晶体振荡器。广泛应用于各种通信、导航、雷达、卫星定位系统、移动通信、程控电话交换机、各类电子测量仪表中。公司目前研发生产的TCX0产品已可完全满足无线通讯需要，经公司工程技术人员努力研制的表面贴装温度补偿振荡器（TCX0）产品（2TG2600001）日前通过并加入全球著名的IC设计厂商联发科技股份有限公司（MTK）的MT6625/MT6625L/MT6627/MT6631/MT6630/MT6631方案，该方案主要应用于消费类电子产品的GPS功能。

因公司产品进入联发科相关设计方案，将会对公司未来业绩产生积极影响。该事项对短期业绩无重大影响，而未来市场应用存在较多不确定因素，因此对未来业绩提升存在较大不确定性，敬请广大投资者理性投资注意投资风险。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

2018 年 3 月 23 日